

**关键指标**

频率：2~18GHz

隔离度：15dB

插入损耗：1.0dB

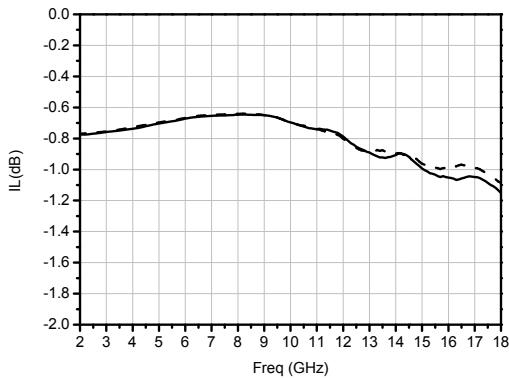
芯片尺寸：1.15mm×0.65mm

**电性能 (T<sub>A</sub>=25℃)**

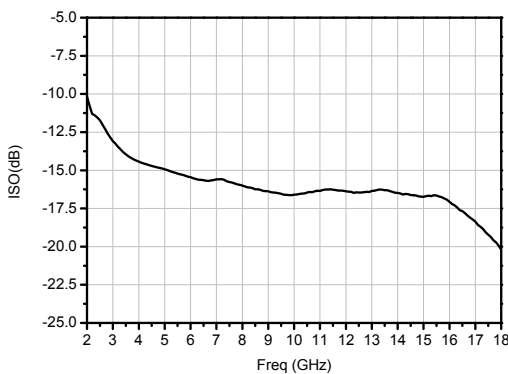
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	2~18		
输入驻波	-	1.3	-
输出驻波	-	1.2	-
插入损耗(dB)	-	1.0	-
隔离度(dB)	-	15	-

**典型测试曲线**

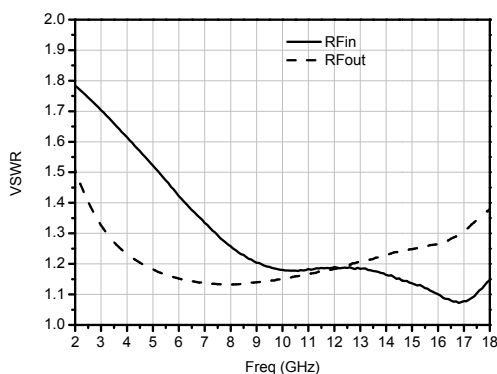
插入损耗



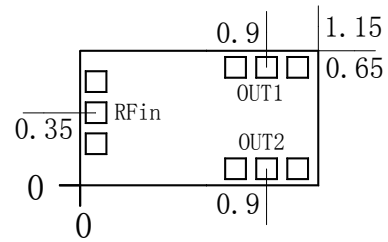
隔离度



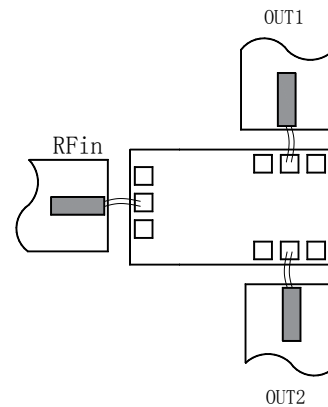
驻波



**外形和端口尺寸 (mm)**



**推荐装配图**



**绝对额定最大值**

最大输入功率	+27dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

**注意事项**

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。